

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2022-094

海南金盘智能科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）于2022年9月29日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以可转债募集资金向桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”）提供总额不超过21,686.00万元（含21,686.00万元）无息借款用于实施“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”；向武汉金盘智能科技有限公司（以下简称“武汉金盘智能”）提供总额不超过58,054.20万元（含58,054.20万元）无息借款用于实施“智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”及“节能环保输配电设备智能制造项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号）同意，金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审验，并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募投项目的基本情况

根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额
1	储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）	21,686.00	21,686.00
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）	40,215.26	40,072.20
3	节能环保输配电设备智能制造项目	49,457.29	17,982.00
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00
合计		129,288.55	97,670.20

三、使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”的实施主体为公司全资子公司桂林君泰福，“智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”和“节能环保输配电设备智能制造项目”的实施主体均为公司全资子公司武汉金盘智能。

为了保障可转债募投项目的实施和管理，公司拟以可转债募集资金向桂林君泰福提供总额不超过 21,686.00 万元（含 21,686.00 万元）无息借款用于实施“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”；向武汉金盘智能提供总额不超过 58,054.20 万元（含 58,054.20 万元）无息借款用于实施“智能装备制造项目-储能系列产品数

字化工厂建设项目（武汉）”及“节能环保输配电设备智能制造项目”。在上述募投项目规定的实施周期内，在上述借款总额范围内视项目建设实际需要分期向桂林君泰福及武汉金盘智能提供无息借款，借款期限为实际借款之日起 10 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”、“智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”和“节能环保输配电设备智能制造项目”的实施，不得用作其他用途。

四、借款对象的基本情况

（一）武汉金盘智能

1、基本信息

公司名称	武汉金盘智能科技有限公司
成立时间	2016 年 12 月 15 日
注册资本	10,000 万元人民币
实收资本	10,000 万元人民币
法定代表人	董圣文
统一社会信用代码	91420115MA4KQ6WJX1
注册地址	武汉市江夏区大桥新区办公楼 808 号
主要生产经营地	武汉市江夏区大桥新区办公楼 808 号
股东构成及控制情况	金盘科技持有 100% 股权
主营业务及其与公司主营业务的关系	作为公司 IPO 募投项目和部分可转债募投项目建设主体
经营范围	输配电及控制设备、工业自动控制系统装置、电气传感器元器件研发、制造、销售；软件研发、销售；电气设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目开发、建设；售电服务；普通货运；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；机电设备及配件、原材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险品）、仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	16,151.05	9,194.66
净资产	8,858.52	9,089.20
净利润	-230.68	-178.93

（二）桂林君泰福

1、基本信息

公司名称	桂林君泰福电气有限公司
成立时间	2010年9月2日
注册资本	30,000万元人民币
实收资本	10,900万元人民币
法定代表人	程晓其
统一社会信用代码	91450300561555030Q
注册地址	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
主要生产经营地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
股东构成及控制情况	金盘科技持股 100%
主营业务及其与公司主营业务的关系	主要负责公司储能系列产品、干式变压器、箱式变电站、中低压成套开关设备、一体化逆变并网装置、SVG 等产品的研发、生产和销售
经营范围	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
总资产	90,109.35	77,766.77
净资产	31,547.03	25,972.54
净利润	5,524.19	4,445.46

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用可转债募集资金向桂林君泰福及武汉金盘智能提供无息借款是基于推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的投向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生影响，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次无息借款将存放于募集资金专户进行管理，公司及其子公司桂林君泰福、武汉金盘智能已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司以募集资金向桂林君泰福提供总额不超过 21,686.00 万元（含 21,686.00 万元）无息借款用于实施“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”；向武汉金盘智能提供总额不超过 58,054.20 万元（含 58,054.20 万元）无息借款用于实施“智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”及“节能环保输配电设备智能制造项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，上述事项已履行了必要的内部审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用募集资金向桂林君泰福提供总额不超过 21,686.00 万元（含 21,686.00 万元）无息借款用于实施“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”；向武汉金盘智能提供总额不超过 58,054.20 万元（含 58,054.20 万元）无息借款用于实施“智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”及“节能环保输配电设备智能制造项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集

资金的使用计划，上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年10月1日